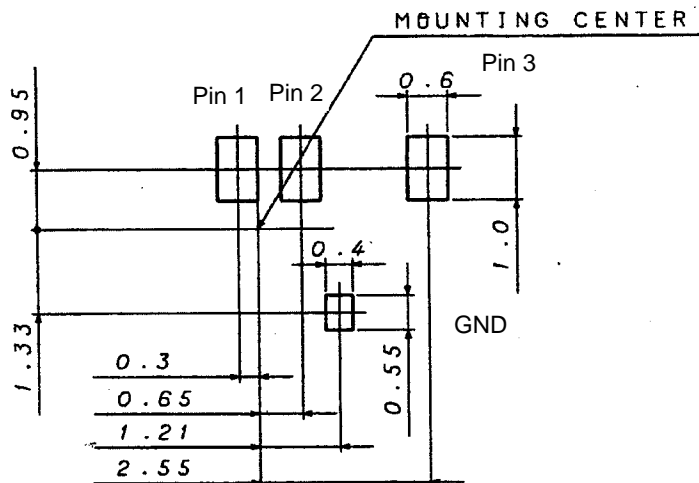


VRSLP3A-H19 推奨ランドパターン仕様

VRSLP3A-H19 Recommended land pattern

参考資料



UNIT:mm

ETH936

(注意) 実際の寸法設定に当っては、実装基板の洗浄性、半田付け強度、ソルダーマスクのパターン精度、半田ブリッジ、リードからの放熱性等を十分に考慮の上、最適なパターンをご設計下さい。

(note) Deviation from above dimensions is necessary as the conditions of

- cleanness of circuit boards
- solder strength
- pattern precision of solder mask
- solder bridge
- lead heat radiation

Design 07.3.-2	Check 07.3.-2	Approval 07.3.-5	Date 2007. 2. 26	Specification Rev. A
ROHM CO., LTD			Specification No.	